

## 研究成果報告書 (掲載期間 2021.11.1-2022.10.31)

### 学術書

- (1) 岩室憲幸, 山田靖: 次世代パワー半導体の開発・評価と実用化, 第2編第3章第1節, NTS, 2022.

### 学会発表

- (1) 北村駿, 山田靖, 竹馬克洋, 俊成修平: メッキプロセスによるパワーデバイス用銅柱グラファイト放熱板, エレクトロニクス実装学会, 第36回春季講演大会, 2022年3月, オンライン開催.

### 受賞

- (1) 山田靖, 八坂慎一, 大浦賢一, 東条三秋: MES2021 ベストペーパー賞, 論文「パワー半導体実装用接合材料の基礎物性と信頼性評価法, 2022年9月.

### 学外競争的研究資金獲得

- (1) 内田圭, : 成長型中小企業等研究開発支援事業/パワー半導体の高密度実装に対応した高放熱セラミックス基板の開発, 2022.